

SLC-M Smart Laser Center

자동위치 인식 / 보정 고정밀 레이저 가공기

FPD & Touch

산업을 위한
독창적인
성과와 디자인



고정밀 CCD 시스템

- 최고사양의 CCD장치로 자동으로 정렬용 기준 마크를 찾아서 위치 보정 진행
- 마크 인식과 그에 대한 위치 보정 작업은 모두 제어용 프로그램에서 자동으로 이루어짐 (AUTO CCD) 전용 프로그램 예의한 진행
- 작업 시간 단축으로 생산성 증대

고정밀 고성능의 기구부

- 고속의 가공속도와 기구부의 안전성 및 높은 반복 정밀도를 위한 독창적인 기구부 디자인
- 고 생산성, 고 절단 정밀도, 고 품질 구현

고품질 절단성

- 효과적인 절단 품질의 향상을 위해서 별도의 변환 프로그램 적용
- 자동 고품질 모서리 가공 기능과 더불어 안정된 레이저 출력

사용자 중심의 손쉬운 운용

- 모든 시스템 제어 환경이 설정된 전용 제어용 PC 적용
- Auto CCD 전용 MMI 프로그램을 통한 시스템 제어로 사용자의 손쉬운 운전
- 다양한 기준 마크 인식과 손쉬운 위치 보정

집진형 가공 테이블과 배기 장치

- 가공 테이블의 하단에 집진장치 및 분진함 설치
- 가공시 상단에서 발생되는 가스의 실시간 배기 장치

SLC-M

Smart Laser Center

시스템 사양

크기	1250(L) x 1000(W) x 1242(H) mm (PC 제외)
작업 영역	600 x 500mm(3.62" x 19.68") (CCD 인식 제외시)
Z축 이송거리	20mm(자동 또는 수동 이송)
레이저 사양	RF CO ₂ 레이저 60 / 100W 공냉식
레이저 파장	10.6 μ m
초점 사이즈	$\varnothing = 0.076$ mm
절단 폭	0.1 ~ 0.2mm
최고 절단속도	750mm/sec (29.52 inch/sec)
분해능 (DPI)	4064, 2032, 1354, 1016, 812, 677
반복 정밀도	± 0.02 mm
작업 모드	Vector Cutting and Spot Drilling
픽셀	(640 x 480)
인터페이스	Ethernet, RS232C, USB
무게	550 Kg
적색 빔 포인터	LD 포인터 (적색 빔)
요구 배기 장치	1HP 이상
최소 배기 용량	3.0m ³ / min 이상
전력	220VAC, 15A, 20A
공기압	2Kg/cm ²
제어 시스템	고사양의 제어용 PC 제어 PC 전체 크기 : 1850 x 100 x 1242(착탈식) Auto CCD 전용 프로그램 SLC 본체, 제어 패널
배기장치 및 요구사항	$\varnothing 100 \sim \varnothing 75$ mm 요구 주변온도: 15°C ~ 35°C, 58°F ~ 85°F



엘피텍

본사 : 경기도 성남시 중원구 상대원동 5445
우림라이온스밸리3차 903호
Tel : 031 - 720 - 5450
Fax : 031 - 720 - 5459
<http://www.lptech.co.kr>
E-mail: lpotech@lptech.co.kr
지사 :